

2024年7月8-10日

上海新国际博览中心

国际嵌入式系统创新论坛

International Embedded System Innovation Forum



基本信息 General Information

会议时间 : Date :	2024年7月8日或9日 July 8 or 9, 2024
会议地点 : Venue	上海新国际博览中心 Shanghai New International Expo Center
主办单位 : Organizer :	慕尼黑展览 (上海) 有限公司 Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.
会议语言 : Language :	中文或英文 , 现场不提供同声传译 (建议英文演讲嘉宾使用双语PPT) Chinese or English, no simultaneous interpretation (Non-Chinese speakers are recommended to use bilingual slides)
演讲资料提交 : Material Submission Deadline :	- 中英文演讲题目、演讲文简介和照片、250字演讲摘要提交 : 截止日期2024年4月30日 - 演讲PPT提交 : 截止日期2024年5月31日 - Bilingual info of subject and speaker, presentation abstract of 250 words: Apr 30, 2024 - Complete PPT submission: May 31, 2024

主要议题 Topics

- 嵌入式人工智能、多核高性能处理器以及RISC-V 产业生态
- 工业物联网、电机控制、智慧能源以及MCU物联网生态
- Embedded AI, Multi-Core High-Performance Processors, and the RISC-V Industrial Ecosystem
- IIoT, motor control, smart energy and MCU IoT ecology

2023 论坛议程 2023 Agenda

上午主题：人工智能

AM Session: Embedded AI

主持人：何小庆，《单片机及嵌入式系统应用》杂志，编委会副主任

Moderator: Allan He, Deputy Director of Editorial Board, MCU and Embedded System Application Journal

演讲题目 Presentation	演讲嘉宾 Speaker
签到入场 Registration	
基于手机GPU的高能效的二值神经网络推理引擎以及加速应用 PhoneBit: Efficient GPU-Accelerated Binary Neural Network Inference Engine for Mobile Phones	陈刚，中山大学，副教授 Gang Chen, Associate Professor, Sun Yat-sen University
基于Arm生态的边缘端ML实现 ML on Edge Devices - A practical approach	杨瑞，安谋科技中国有限公司，高级市场经理 Eric yang, Senior Marketing Manager, Arm China
意法半导体边缘人工智能 - 引领嵌入式人工智能新时代 ST Edge AI - Leading a New Era of Embedded AI	丁晓磊，意法半导体，意法半导体微控制器市场部门市场经理 Lisa DING, Marketing manager, Microcontroller group, STMicroelectronics
端侧智能语音AIoT芯片--赋能家电智能化升级 Edge Smart Voice AIoT chip -- Make a smarter home	张来，成都启英泰伦科技有限公司，联合创始人 Lai Zhang, Co-Founder, Chipintelli

下午主题：物联网

PM Session: Internet of Things

主持人：胡晓柏，北京航空航天大学出版社，嵌入式系统图书分社副社长

Moderator: Xiaobo Hu, Vice President of Embedded System Book Bureau, Beihang University Press

演讲题目 Presentation	演讲嘉宾 Speaker
瑞萨全“芯”赋能中国大工业Renesas MCU Fully Empowers China Smart Factory	谭绍鹏，瑞萨电子（中国）有限公司，高级经理 Johnson Tan, Senior Manager, Renesas Electronics (China) Co., LTD
多元化“芯”产品生态赋能汽车工业能源大市场 Nations Products Fully Empowers Vehicle, Smart Factory and Energy Source	钟新利，国民技术股份有限公司，总经理助理 Kerwin Zhong, General manager assistant, Nations Technologies Inc.
ADI创新技术加速工业4.0，共同实现产业转型 ADI's innovative technologies accelerate Industry 4.0 and achieve industrial transformation	蔡振宇，亚德诺投资有限公司，ADI公司中国区工业市场总监 Eric Cai, Marketing Director, ADI China Industrial Business, Analog Devices Inc.
布局高可靠性领域，5G+IoT时代仍是好机遇 Layout in the field of high reliability, 5G+IoT era is still a good opportunity	陈磊，东芯半导体股份有限公司，副总经理 Lei Chen, Dosilicon Co., Ltd, vice general manager
新一代Apollo SoC助力数字健康领域成长 Propel the Grow of Digital Health with the New Generation of Apollo SoC	俞诗鲲，恩佰科（深圳）电子有限公司，市场总监 Percy Yu, Director of technical marketing, Ambiq Mirco.
恩智浦人工智能硬件平台及开发环境赋能物联网应用 NXP AI Hardware Platform and Development Environment Enables IoT Applications	刘昱炜，恩智浦半导体，大中华区产品市场经理 Kelly Liu, GC Regional Marketing Manager, NXP Semiconductors
新型基础设施的底座：物联网芯片与物联网操作系统 The foundation of the new infrastructure: IoT chips and IoT operating systems	何小庆，单片机与嵌入式系统应用杂志社，编委会副主任 ALLAN HE, Deputy Director of the Editorial Board, MCU and Embedded System Application Magazine

2023 现场盛况 2023 grand occasion



2023 听众抽样名单 2023 Audience sample list

观众人数 : 395人
Attendance : 395

单位名称	Company
华为技术有限公司	Huawei Technologies Co., Ltd.
中国联通	CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS LIMITED.
中国船舶重工集团有限公司	China Shipbuilding Industry Group Co., Ltd.
西门子(中国)有限公司	Siemens Ltd China
三菱电机自动化(中国)有限公司	MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMATION (CHINA) LTD.
霍尼韦尔(中国)有限公司	Honeywell (China) Co., Ltd.
阳光电源股份有限公司	Sungrow Power Supply Co., Ltd.
施耐德电气(中国)有限公司	Schneider Electric (China) Co., Ltd.
蔚来汽车	NIO NEXTEV LIMITED
博世汽车零部件(苏州)有限公司	Bosch Automotive Products (Suzhou) Co. Ltd.
大陆投资(中国)有限公司	Continental Holding China Co., Ltd.
曼德电子电器	MIND Electronics Appliance Co., Ltd.
泛亚汽车技术中心	Pan-Asia Technical Automotive Center
李尔公司	Lear Corporation
宝适汽车部件(太仓)有限公司	Bos Automotive Systems (Taicang) Co., Ltd.
大陆智行科技(上海)有限公司	CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SHANGHAI CO LTD.
北京地平线信息技术有限公司	Horizon Robotics
黑芝麻智能科技有限公司	Black Sesame Technologies Co., Ltd.
公牛集团股份有限公司	GONGNIU GROUP CO.,LTD.
欧姆龙电子部件(深圳)有限公司	Omron Electronic Components (Shenzhen) Ltd.
海尔智家股份有限公司	Haier Smart Home Co., Ltd.
博西华家用电器有限公司	Bsh Home Appliances Co., Ltd.
欧普照明股份有限公司	Oppl Lighting Co., Ltd.
星络家居	Xingluo Intelligent Technology Co., Ltd.
飞利浦医疗(苏州)有限公司	Philips Healthcare(Suzhou)Co.,Ltd.
上海西门子医疗器械有限公司	Siemens Shanghai Medical Equipment Ltd.
美的集团	Midea Group
珠海格力集团有限公司	ZHUHAI GREE GROUP Co.,Ltd.
四川长虹网络科技有限公司	Changhong Network Technologies Co., Ltd.
英飞凌科技股份有限公司	Infineon Technologies
高通无线通信技术(中国)有限公司上海办事处	Qualcomm Wireless Communication Technologies (China) Co.,Ltd. Shanghai Office
松下神视电子(苏州)有限公司	Panasonic Industrial Devices SUNX Suzhou Co., Ltd.
中移物联网有限公司	China Mobile IOT Company Limited
上海诠诺物联网技术有限公司	Shanghai Qnode Technology Co., Ltd
镭云科技	ZIYUN Technology
江苏省产业技术研究院脑机融合智能技术研究所	BRAIN MACHINE FUSION INTELLIGENCE INSTITUTE
德州仪器半导体技术(上海)有限公司	Texas Instruments Semiconductor Technologies (Shanghai) Co., Ltd.
研华科技(中国)有限公司	Advantech Corporation
神州数码集团股份有限公司	Digital China Group Co.,Ltd.
阿里云计算有限公司	Alibaba Cloud